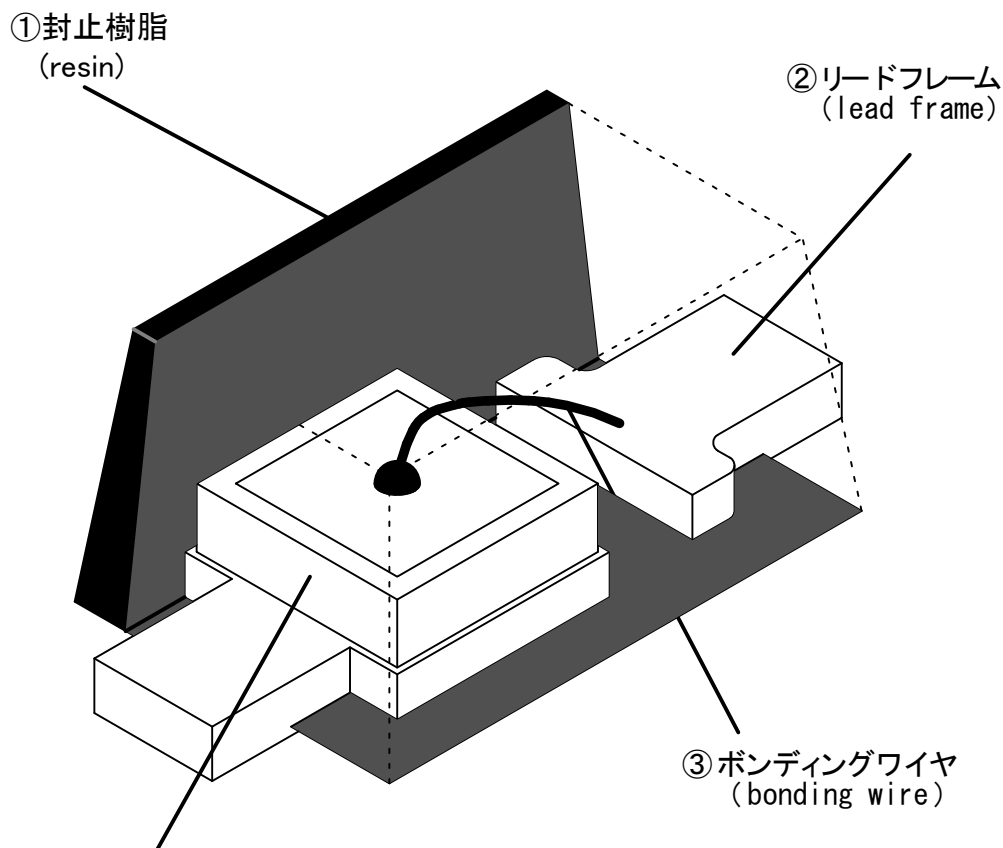


SOD723構造図
SOD723 Perspective

RoHS対応品
RoHS Compliance



項目 item	④シリコンチップ (Si)	材料 material	備考 Note
①	封止樹脂 resin	エポキシ樹脂 Epoxy resin	難燃グレード/Flammability rating UL94V-0
②	リードフレーム lead frame	Fe-Ni系 Fe-Ni alloy	
	端子処理 lead plating	鉛フリーはんだメッキ Lead(Pb) free solder plating	
③	ボンディングワイヤ Bonding wire	Au	
④	シリコンチップ Si	Si	

捺印表示 marking	レーザー laser marking
-----------------	-----------------------

※ダイアタッチは金共晶接合
Au eutectic alloy is used for die attachment.